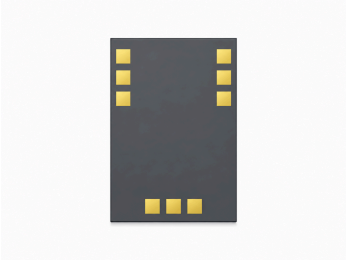
10000–20000 MHz Die divisor de potência GaAs IPD de 2 vias e 0°

Isolamento: 30 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de saída: 1.2 (típico). Dimensões do die: 0.9 × 1.3 × 0.1 mm.



Características RF · TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Frequência de operação	-	10000	-	20000	10000–20000	MHz
Isolamento	-	-	30	-	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.2	-	-	-
VSWR de saída	-	-	1.2	-	-	-

Valores limite

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Potência de entrada máxima	-	-	-	30	dBm

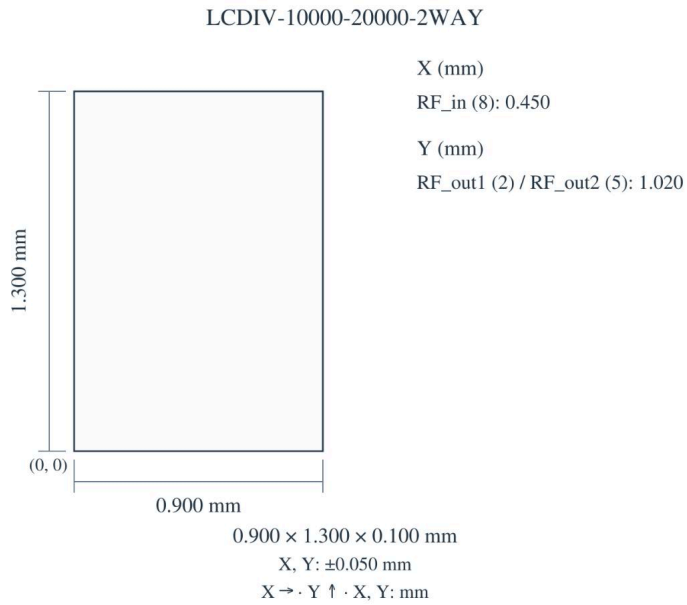
Condições ambientais

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de operação	-	-55	-	85	°C

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	0.9 × 1.3 × 0.1	mm

Desenho dimensional mecânico



Todas as dimensões estão em mm [in].

Atribuição dos pads de ligação

Terminais	Símbolo	Função	Observações
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Terra; não requer fio de ligação	-
2	RFout1	Saída RF	1
5	RFout2	Saída RF	2
8	RFin	Entrada RF	-

Registro da publicação atual · 1.3 · 2026-10-27. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.2.

Escopo da referência mecânica

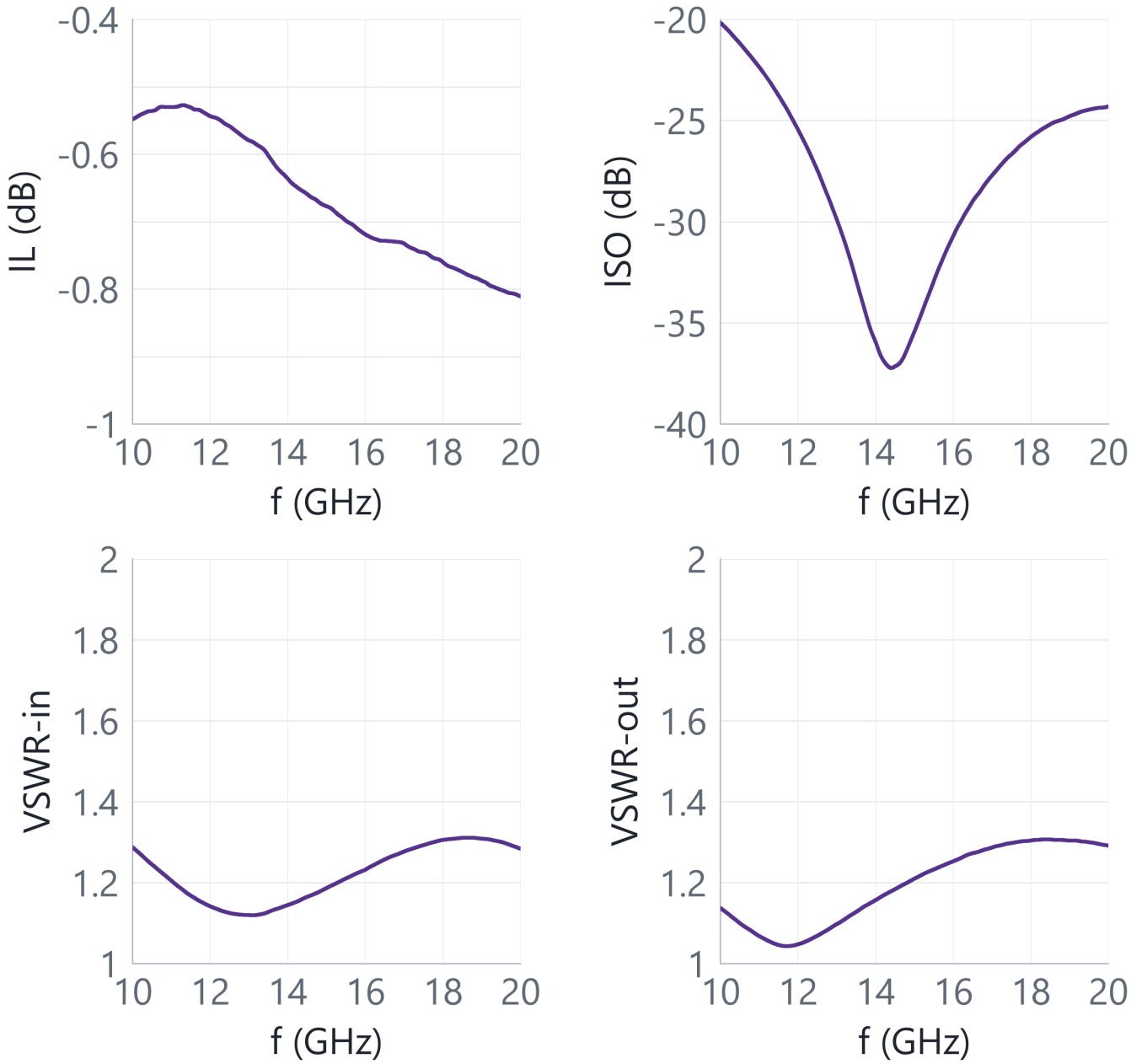
Referência dimensional em mm baseada na documentação de origem. Informações parciais; não constitui um desenho completo de fabricação ou de ligação por fios.

Curvas de desempenho

Gráficos da ficha técnica original. Considere as condições de operação indicadas em cada figura.

Perda de inserção; Isolamento; Casamento de entrada; Casamento de saída.

Gráfico redesenhado a partir da figura original; as leituras são aproximadas.



Fonte

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.